

布局智能硬件再掀热潮 互联网企业如何打破魔咒？



本报记者 王伟

近日,今日头条母公司字节跳动准备进军硬件领域,开发自己的智能手机的消息不胫而走。在今年1月,字节跳动收购锤子科技部分专利使用权时,就有业内人士猜测字节跳动有可能会进军手机或者智能终端,对此字节跳动回复称:“字节跳动收购了锤子科技部分专利使用权,探索教育领域相关业务。因为具体交易涉及保密条款,不便披露。”

无独有偶,近期,另一互联网巨头腾讯将入局游戏手机的消息也有板有眼,在业界流传开来。消息称腾讯互动娱乐事业群(IEG)旗下的智能创新业务部(Inlab)正在尝试做一款游戏手机。为此,腾讯已经和包括包括华硕、闻泰、雷蛇等原始设计厂商有过接触。

2014~2016年,全球互联网巨头纷纷推出自己的智能手机或智能硬件,但成功者寥寥。如今字节跳动和腾讯再次“试水”,难道互联网企业布局智能硬件的风潮又要卷土重来?他们能打破“互联网企业做不成硬件”的魔咒吗?

互联网巨头都有一个“硬件梦”?

回顾以往,互联网企业试水智能手机等智能硬件的案例不绝于耳。百度先后发布了渡鸦智能音箱、小度在家带屏智能音箱和小度智能音箱三款智能音响产品,还与海尔等家电品牌联手,欲抢占智能家居语音入口。天猫发布了AI购物智能音箱天猫精灵X1和天猫路由。腾讯发布了小Q机器人和听听AI音箱,京东也发布了叮咚智能音箱,360发布了安全门锁和智能手机。

为何互联网巨头都有一个“硬件梦”呢?赛迪顾问物联网产业研

究中心邹德宝在接受《中国电子报》记者采访时表示,就目前阶段来看,互联网软件服务对硬件产品的依存度较高,硬件产品和软件服务的关系好比躯体和灵魂,没有躯体的灵魂无法充分发挥服务价值,所以即便智能硬件的附加值低,互联网企业仍然投身智能硬件产品领域。

而在众多智能硬件中,智能手机是被巨头盯上的香饽饽。2014年,亚马逊推出Fire手机,合约价曾从200美元降到0.99美元,成为导致亚马逊当年Q3季度亏损5.44

亿美元的主要原因。2016年,美国谷歌公司推出了搭载谷歌手机操作系统的Pixel系列手机,但由于价格高、摄像头表现一般和外形一般等原因,市场表现遭遇滑铁卢。国内方面,2015年,360与酷派联合推出的奇酷手机以及乐视推出的“硬件零利润”的乐视超级手机IS,也都如过眼云烟一般消失在人们视野中。时隔多年,如今腾讯和字节跳动再次盯上智能手机,又是何为?

赛迪顾问信息通信产业研究中心高级分析师李联在接受《中国电子报》记者采访时表示,在5G时

代到来之时,智能手机作为新一代通信技术落地的必备终端设备,不仅仅是人与人之间交流的工具,更可以作为人与物、物与物互连接、万物互联的传感器,可以实现5G时代的机器通信、自动驾驶等多种应用场景。因此,智能手机在未来5G时代将是最重要的移动终端,提前布局对于所有企业来说都将是有益无害的。

代到来之时,智能手机作为新一代通信技术落地的必备终端设备,不仅仅是人与人之间交流的工具,更可以作为人与物、物与物互连接、万物互联的传感器,可以实现5G时代的机器通信、自动驾驶等多种应用场景。因此,智能手机在未来5G时代将是最重要的移动终端,提前布局对于所有企业来说都将是有益无害的。对于互联网公司来说,不仅可以拓宽自己的市场,占据更大市场份额,同时软硬件生态结合,也提高了软件产品的附加值。

互联网企业要扩大软件服务与智能硬件功能的融合性,加强硬件产品供应商和代理商的溢价能力。

QQ,而字节跳动则在自媒体、娱乐和资讯等方面做到了业内前列。因而,两家企业只要设计出与自身软件生态相吻合的硬件,便可占有智能手机市场的份额。

面对智能手机等智能硬件背后隐藏的巨大商机,互联网企业如何抓住机遇呢?对此,邹德宝的建议是,互联网企业需要注意要扩大自身软件服务与智能硬件功能的融合性,加强硬件产品供应商和代理商的溢价能力,加强独立创新,在操作系统、软件服务方面加强技术创新和服务创新,避免智能硬件产品功能和服务的同质化效应。

半导体产业进入新一轮并购期

(上接第1版)尽管看来,这一轮的半导体增速放缓来自存储器价格回归理性以及矿机市场回落的拖累,但就像多米诺的骨牌,在5G、自动驾驶等新需求尚未完全规模启动时,在新旧技术的换挡期,某几个关键产品的下滑就有可能带动整个产业的持续下滑,而且几乎所有的分析机构都给出了“市场至少要到2020年才能复苏”的类似结论。

在这样的背景下,进行调整,打造新能力,为新增长的到来做好准备,就成为半导体企业的必须选择。一方面过去几年半导体市场处于上行周期,企业普遍盈利状况良好,储备了大量现金,“企业有钱”,这为调整期的企业并购整合,提供了“弹药”。另一方面,即将到来的5G、自动驾驶、物联网等新市场,需

要新技术、新解决方案以及新服务方式,半导体企业要想能够在下一个高潮期到来大规模获利,必须提前准备好新的“布袋子”,迎接新机会来到“囊中”。

而事实上,半导体产业的调整已经给出了趋势性的方向。

首先,用户需要更全面、更丰满的半导体产业链组合。就像这次英飞凌对赛普拉斯(Cypress)的收购,英飞凌首席执行官明确表示,通过交易,英飞凌能为客户提供最全面的产品组合。提供新组合,开拓新市场,是这次收购的关键词。赛普拉斯拥有包括微控制器、软件和连接器组件,与英飞凌的功率半导体、传感器和安全解决方案高度互补,让英飞凌能够加速进入工业和消费市场以及汽车半导体市场。收购完成

后,英飞凌将一跃成为成为全球最大的汽车半导体厂商。

赛迪顾问不久前发布的《全球半导体市场趋势白皮书》(以下简称白皮书)也给出了同样的判断:随着产品竞争日益加剧,产业竞争模式正在向体系化、生态化方向演进变革。一方面,围绕新兴领域生态布局的兼并重组活跃。软银收购ARM布局物联网领域,三星收购汽车电子零部件供应商哈曼公司进入汽车电子行业,英特尔收购以色列公司Mobileye打造无人驾驶领域的整体解决方案。另一方面,整机和互联网等应用企业涉足上游芯片领域成为产业发展新特征。终端企业为了维持综合竞争实力,通过使用定制化芯片产品,实现整机产品具备差异化与系统化优势。继苹果

公司后,谷歌、亚马逊、Facebook、特斯拉等应用企业纷纷进入半导体领域,自研或者联合开发芯片产品,等等,都进一步验证了这样的趋势。

其次,全球半导体技术正酝酿新的变革,技术正在面临新的变迁,从硅基半导体到化合物半导体,从冯诺依曼架构到“非冯诺依曼”架构,新工艺、新材料、新器件不断涌现,更多的可能性正在不断发生,更多维度、更多领域技术的融合碰撞,正在激发出新的技术火花,都将进一步驱动半导体产业加速整合。

半导体产业进入新一轮并购期的大幕刚刚拉开,紫光微收购法国Linxens公司,英飞凌收购赛普拉斯,只是这个并购季的开幕序曲,等着吧,更多的并购戏即将粉墨登场。

中国AR/VR市场高速增长 支出规模领先于全球

6月6日,IDC发布《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》(以下简称《指南》)。IDC预测,至2023年,中国AR/VR市场支出规模将达到652.1亿美元,较2019年的预测(65.3亿美元)有显著增长。同时,在预测期内(2018-2023年),5年复合年增长率(CAGR)将达到84.6%,高于全球市场78.3%的增长率。

在行业应用方面,IDC预计中国AR/VR市场在商用领域的投资将持续加速增长,并且进一步拓展AR/VR技术在多个商用行业的应用。在预测期内(2018-2023年),5年复合年增长率(CAGR)最高的3个行业都属于商用领域,依次为医疗保健行业、公用事业和银行业,皆已超过100%。而另一方面,虽然在预测期内消费行业的支出数额仍居各行业之首,但其增长速度较商用领域将放缓,5年CAGR预计为73.9%。

IDC中国终端系统研究部市场分析师谭睿指出:“进入2019年,AR/VR设备迎来技术迭代更新,消费级产品价格不断下探,行业生态在商用与消费两端的发展走向愈发清晰。随着网络基础设施建设的进一步成熟,公共部门、基础架构、金融等行业将会有更多的生态参与者进行布局,以硬件、软件以及服务为一体的商业模式将会带动中国地区支出规模迎来快速增长。”

从应用场景来看,IDC认为,除了通过行业维度对AR/VR市场进行洞察,进一步细分的应用场景,可以更清晰的透视AR/VR市场的发展变化。IDC预测,至2023年,商用领域的应用场景中,支出规模最大的依次为培训(27.5亿美元)、零售展示(21.4亿美元)

和工业维修(16.2亿美元)。而在消费领域,3个应用场景(VR游戏、AR游戏、VR视频)的支出规模预期将于2023年达到95.9亿美元。在预测期内(2018-2023年),有14个应用场景的5年CAGR将超过100%,其中增长最快的为AR游戏、解剖学诊断以及虚拟测试驱动。

从技术应用看,在行业与应用场景之外,IDC认为,技术维度也能对AR/VR市场进行有效洞察。2019年,中国AR/VR在硬件领域的投入占比将达到59.5%,超过整体的一半,其次是软件市场及服务市场。本期硬件类别中将“主机设备”进行了拆分,分为“AR主机设备”和“VR主机设备”。IDC预测在2019年,支出规模最大的硬件为VR主机设备,但增长最快的为AR头显(5年CAGR为223.9%),并将于2023年成为支出规模最大的类别。增长率仅次于AR头显的是AR软件,预计将于2023年超过VR软件的支出总额。服务市场总体增长较快,主要由AR咨询、AR定制化应用开发以及AR系统集成的高增长率带动。虽然目前VR在市场上的支出要高于AR,但AR硬件、软件和服务的快速增长会将AR整体支出推向新的台阶,并在预测阶段结束时整体超过VR市场的支出。

IDC中国新兴科技研究部市场分析师姚雨墨表示:“随着AR技术在中国市场的快速发展,以及与AR相关的应用场景不断涌现,各行各业正在认识到AR技术在商用领域的价值。制造业、公用事业、建筑业、教育等行业正在提高采用AR技术的比例,并将其应用在工业维修、装配安全、实验室等应用场景中。”

车用半导体上演龙头争夺战

(上接第1版)根据公开资料,英飞凌是全球最大的功率半导体和智能卡芯片供应商,汽车半导体业务排名全球第二,在英飞凌所拥有的汽车(ATV)、电源管理及多元化市场(PMM)、工业功率控制(IPC)及数字安全解决方案(DSS)四大业务部门中,汽车业务占比最大,占全公司收入比例达43%。

“在汽车半导体领域,英飞凌的强项在于车用的功率半导体和电源管理、汽车用系统芯片和各种传感器。而在汽车信息娱乐系统需要用到蓝牙等无线技术,英飞凌还需要产品线来补强,赛普拉斯的产品线正好可以补强。”韩晓敏指出。此外,赛普拉斯拥有的微控制器、软件和连接组件等产品组合,也可以用于工业的电动马达、电源,以及智能家电、消费电子及医疗等物联网设备中。对于英飞凌有较强的互补性。

汽车、工业半导体
将成竞争焦点

汽车、工业、物联网正在成为半导体公司下一个竞争的焦点。“如果说前几年上述市场的竞争还不太激烈的话,随着智能手机等市场减缓,汽车电子、智能工业越来越走向成熟,这几个领域已经开始受到半导体公司的高度重视。”韩晓敏说。

正是在这一背景下,半导体公司纷纷强化在这一领域的布局。近日,全球最大的车用半导体公司恩智浦收购了Marvell的无线事业部,意在加强连接方面的产品线布局。而同属车用半导体前三强的瑞萨电子更是在近两年中,先后收购了Intersil和IDT两家模拟IC公司,丰富自身的产品组合。英飞凌本次对赛普拉斯的收购,其目的显然也是在强化上述领域的布局,以应对未来的竞争。未来半导体公司在汽车、工业半导体领域的竞争将会更加激烈。

根据英飞凌新闻稿发布的信

息:基于2018财年营收100亿欧元,此交易将使英飞凌成为全球第8大芯片制造商(原来排名第10)。在原来已具全球领先地位的功率半导体和安全控制器的基础上,英飞凌更将成为汽车电子市场首屈一指的芯片供应商。

“强者恒强是半导体发展的大趋势,而丰富旗下产品线也将成为发展趋势之一。在这样的发展背景下,预计未来在汽车、工业半导体领域有可能还将有更多新的并购出现。”韩晓敏指出。

巨资收购存挑战

目前,全球的半导体行业正在进入调整时期。根据IHSMarkit数据,2019年全球半导体芯片行业的营收将下降7.4%,营收将从2018年的4820亿美元下降至2019年的4462亿美元。在此情况下,英飞凌也面临着更大的业绩压力。5月8日,英飞凌公布了2019财年第二季度的业绩报告,预测全年度增长率仅为5%,而过去三年英飞凌营收复合年均增长率是9.5%。英飞凌首席执行官Reinhard Ploss博士坦诚:“市场增速明显放缓,高速增长的时代已暂告一段落,客户需求正在回调。在3月底,我们顺应这一趋势,调整了全年的预期,做好增长放缓的准备。”

在此情况下,英飞凌却斥资收购赛普拉斯公司,这一收购行动必将会给英飞凌带来更大的财务压力。这显然对于英飞凌来说将是一项挑战。

“收购赛普拉斯,将使英飞凌进入新的IoT领域,这对英飞凌也将是一个挑战。”韩晓敏认为。此前,英飞凌虽然也对物联网领域有所涉及,但是产品更多偏向功率器件和电源芯片,而赛普拉斯的产品多集中在连接芯片、MCU等方面,客户需求与以往是不同的。如何向客户提供更加完备的售后支撑,将是一个挑战。”